

製品規格/Product Specification 品種名/Type Number: UNR311100 L 1)	DESIGNED	CHECKED	CHECKED	APPROVED

種別/Type	シリコントランジスタ/Silicon Transistors					
用途/Application	デジタル回路用/Digital Circuit					
構造/Structure	PNPエピタキシャルプレーナ形/PNP Epitaxial Planar Type					
外形/Out line	SSSMini3-F1			マーク記号/Marking	6A	
絶対最大定格/ Absolute Maximum Ratings	V _{CB0}	V _{CE0}	I _C	P _T	T _j	T _{stg}
	-50	-50	-100	100	125	-55~+125
	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(°C)

電気的特性/Electrical characteristics (T_a=25±3°C)

項目/Item	記号/ Symbol	測定条件/Measuring condition	typ.	Limit		Unit
				min.	max.	
コレクタ耐圧 Collector to Base Voltage	V _{CB0}	I _C =-10μA, I _E =0		-50		V
コレクタ耐圧 Collector to Emitter Voltage	V _{CE0}	I _C =-2mA, I _B =0		-50		V
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	I _{CB0}	V _{CB} =-50V, I _E =0			-0.1	μA
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	I _{CE0}	V _{CE} =-50V, I _B =0			-0.5	μA
エミッタ遮断電流 Emitter Cutoff Current	I _{EB0}	V _{EB} =-6V, I _C =0			-0.5	mA
直流電流増幅率 Collector to Emitter Saturation Voltage	h _{FE}	V _{CE} =-10V, I _C =-5mA		35		-
コレクタ飽和電圧 Collector to Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _C =-10mA, I _B =-0.3mA			-0.25	V
ハイレベル出力電圧 Output Voltage High Level	V _{OH}	V _{CC} =-5V, V _B =-0.5V, R _L =1kΩ		-4.9		V
ローレベル出力電圧 Output Voltage Low Level	V _{OL}	V _{CC} =-5V, V _B =-2.5V, R _L =1kΩ			-0.2	V
入力抵抗 Input Resistance	R _I		10	-30%	+30%	kΩ
抵抗比率 Resistance Ratio	R ₁ /R ₂		1.0	0.8	1.2	-
トランジション周波数 Gain Bandwidth Product	f _T	V _{CB} =-10V, I _E =1mA, f=200MHz	80			MHz

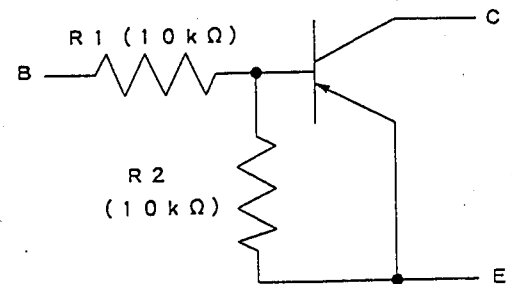
Note: 測定方法は、日本工業規格 JIS C 7030 トランジスタ測定方法による。

Measuring methods are based on JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS C 7030 Measuring methods for transistors.

1) 包装/Packing

Code	包装形態 /Packing form
L	エンボスTXタイプ/embossed TX type

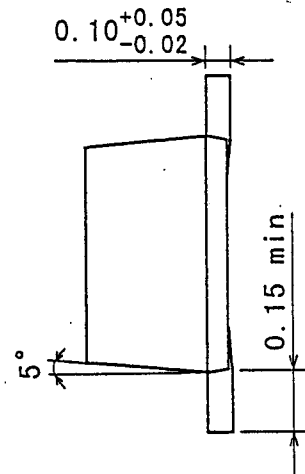
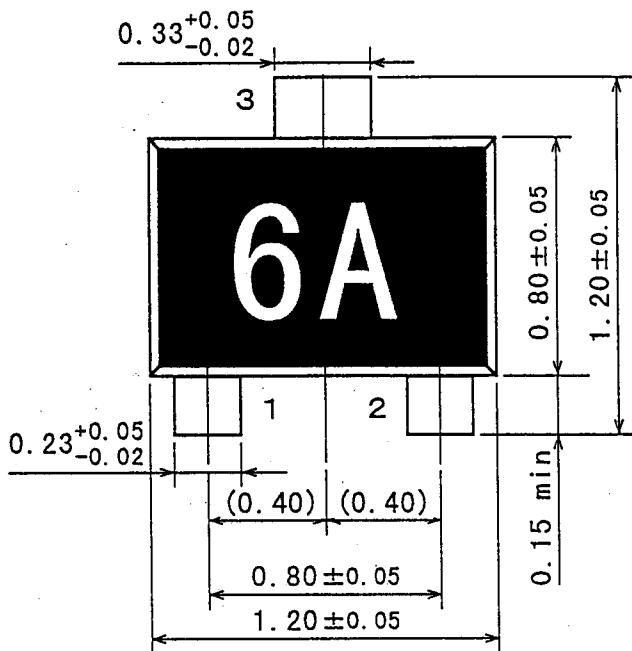
内部接続図/Internally connected circuit



02.01.24			
----------	--	--	--

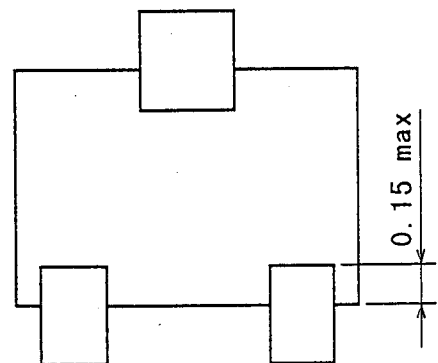
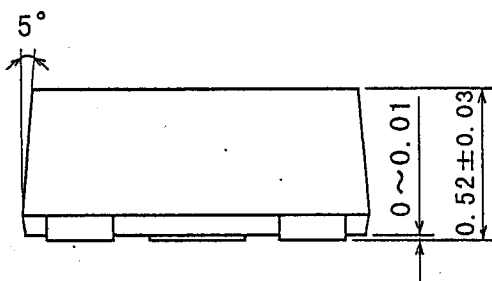
製品規格/Product Specification
 外形図/Out Line
 品名/Type Number: UNR 3 1 1 1 0 0 L
 1)

単位/Unit : mm



注) 品名略号のみ表示
 Display at trademark

- 1. Base
- 2. Emitter
- 3. Collector



項目/Item	内容/contents
リード材質/Lead Material	銅系/Cu
リード処理/Lead Process	はんだめっき/Solder plating
モールド材質/Mold Material	エポキシ樹脂/Epoxy

02.01.24			